

素子内蔵コネクタ

量産品

1980年代搭載開始

- ・「チップ実装 + トランスファ成形技術」を活用した商品
- ・柔軟な回路設計、突発的な回路変更のニーズに応える

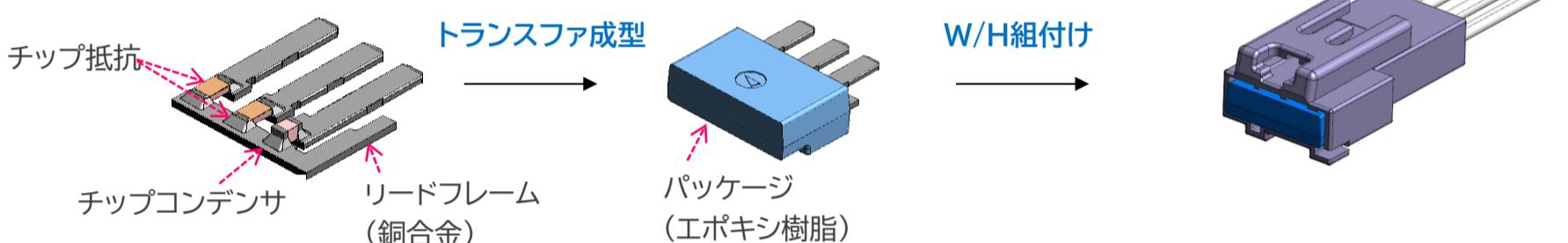
背景・課題

基板レスで、直接W/H回路上に電子部品を搭載するニーズに応える

課題への解決・特徴

①チップ部品を内蔵したコネクタ形状

例:CAN終端抵抗



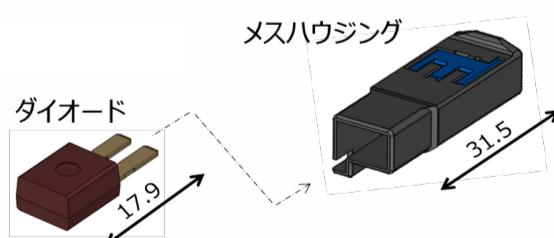
W/H回路上の任意の位置にコネクタを設定し電子部品を配置することが可能

②多様なラインナップから選択可能

I. ダイオード

電流の回り込み防止が必要な回路における整流作用として使用

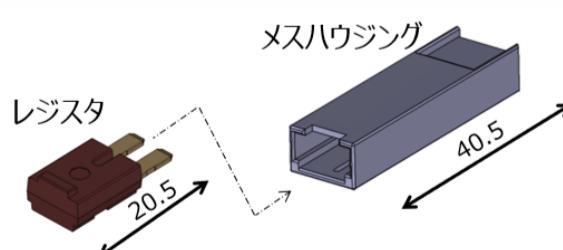
逆耐圧	400V
出力電流	1.5A、3.0A (複数素子内蔵タイプもあり)
使用温度	-30~80°C
端子サイズ	W2.3、W1.8
耐震性	44m/s ² @3軸-300hr



II. レジスタ

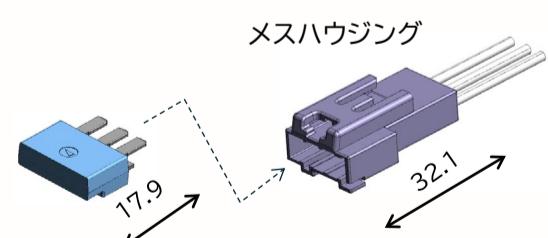
電流制限、分圧などの用途に使用

抵抗値	2.2kΩ、2.7kΩ (複数素子内蔵タイプもあり)
定格電力	0.5kW
使用温度	-40~65°C
端子サイズ	W2.8、W2.3
耐震性	44m/s ² @3軸-300hr



III. CAN終端抵抗

抵抗値(R1/R2)	60.4Ω / 60.4Ω
静電容量 (C1)	0.047μF or 0.015μF or 0.0047μF
使用温度	-40~85°C
端子サイズ	W2.3
耐震性	44m/s ² @3軸-300hr



Check here!



年間2,500万個 / シリーズ累計5億個 を生産

※内蔵する電子部品のカスタムはご相談ください